Lid2110-C1 带胶盖板规格书

1 适用范围

此标准适用于苏州华太电子技术股份有限公司的 Lid2110-C1 带胶盖板产品，型号为 Lid2110-C1。

2 产品

2.1 产品

Lid2110-C1 带胶盖板，型号：Lid2110-C1

2.2 制造商

苏州华太电子技术股份有限公司

2.3 陶瓷材料

96%氧化铝 颜色：白色

2.4 胶水材料

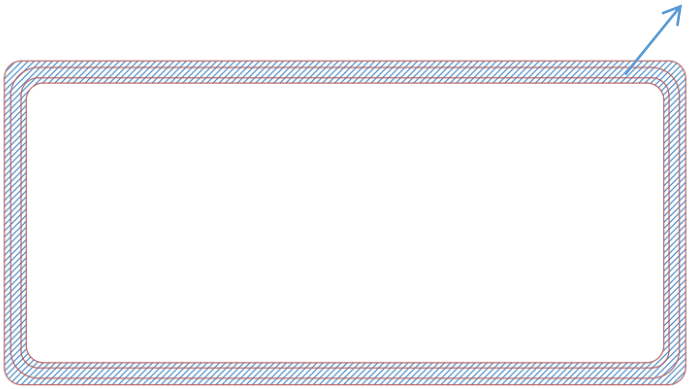
环氧树脂 颜色：白色

密度	1.60±0.04g/cm³
可耐回流焊温度	260°C
玻璃化转变温度 Tg	179°C
最大持续工作温度	200°C
热解温度	>400°C
气密性（MIL-883,，方法 1014，条件 A4)	通过
剪切强度（Au/ ceramics/25°C，psi)	4000

3 要求事项

3.1 定义

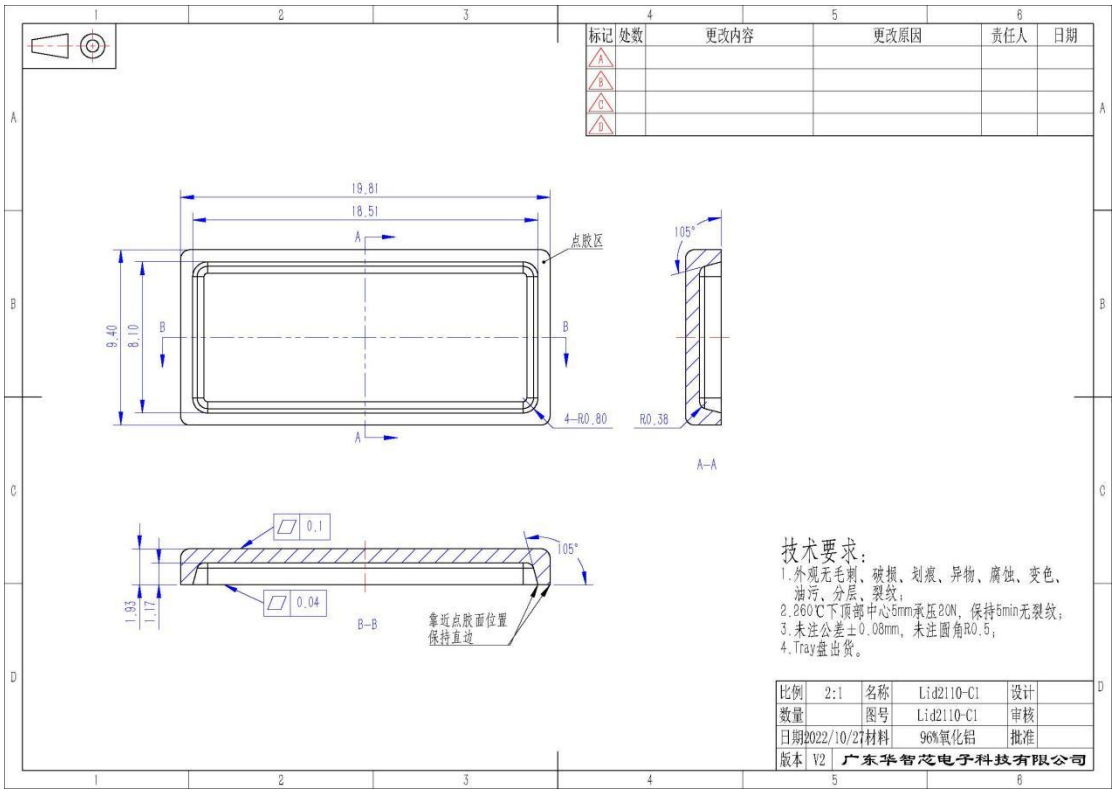
盖板区域定义如下



俯视图

侧视图

3.2 结构尺寸



3.3 陶瓷部分外观

3.3.1 缺料

缺料指主要出现在陶瓷产品的拐角边缘位置和注射填充末端的材料缺少

要求缺料位置宽度≤0.5mm 且深度≤0.2mm

3.3.2 异物和脏污

异物和脏污指除陶瓷和胶水以外的其他物质

要求如果异物和脏污可以被空气吹走则可以被接受

要求异物和脏污粘接在

1）外表面打标印字区域(离盖子边缘 0.5mm)，直径≤0.5mm, N≤5，其他区域 <1.5*1.5mm 面积的污染

2）点胶区域，直径≤0.3mm(小于凸台宽度 1/2)，N≤5

3）其它表面区域，则其直径≤0.6mm 且高度≤0.05mm

3.3.3 裂纹

裂纹指均匀的材料出现破裂但未分离

要求陶瓷部分在 10 倍显微镜下无法观测到裂纹

3.3.4 划伤

划伤指均匀的材料表面出现擦划条形痕迹

要求划伤在

1）印字表面区域(距离盖子边缘 0.5mm)，N≤3, 长度不能超过三个字体宽度，深度≤0.25mm，不能影响印字清晰度

2）点胶区和凸台区域，裸视不能观察到划伤

3）其他外表面区域，划伤长度≤3mm, 或宽度≤1mm

3.3.5 凹坑和凸起

凹坑和凸起指在陶瓷部分表面出现材料的凹陷或突出

要求凹坑和凸起在

1）打标印字区域不能出现，不能影响印字清晰度

2）点胶区和凸台区域，10 倍显微镜下目视无凹凸缺陷

3）其它陶瓷部分区域，直径≤0.5mm 且高度或深度小于 0.1mm

3.4 胶水部分外观

3.4.1 缺料

缺料指点胶过程中胶水分布不均匀，局部位置的宽度和厚度不足

要求胶水高出点胶面高度在 0.2±0.05mm 之间

要求胶水宽度不足不得超过点胶宽度 1/3

3.4.2 异物和脏污

异物和脏污指除陶瓷和胶水以外的其他物质

要求如果异物和脏污可以被空气吹走则可以被接受

要求异物和脏污粘接在胶水表面，则其长度≤0.3mm

3.4.3 流胶

流胶指胶水沿着陶瓷部分的内侧或外侧向下流淌

要求胶水向外侧流淌高度不得超过 1/3

4. 出货检验标准

除特定设置外，依据 GB2828 一般 II 级抽样方案，MAJ 按 AQL=1.0，MOD 按 AQL=2.5，MIN 按 AQL=4.0

严重缺陷(MAJ):影响在客户端生产或在客户处组装后存在结构、尺寸、性能方面的缺陷，含长度、宽度、Lid 厚度、点胶宽度

一般缺陷(MOD):只影响在客户端组装后外观方面的缺陷，含胶水溢胶和断胶

轻微缺陷(MIN):不影响在客户端组装后产品质量的缺陷，含表面轻微凹坑、划痕、脏污

5. 出货检验报告

包含生产厂商、产品型号、批号、数量、生产日期、尺寸检验结果、外观检验结果、功能测试结果、包装标识检验结果

6. 品质报告

项目	更新周期
原材料的安全资料表	2 年
SGS 报告	1 年
产品不含危害物质保证书	1 年
COC 报告	每批次

7. 储存条件

真空包装	保存环境	冷柜	
	保存温湿度	温度：0-8°C；湿度：＜60%	温度：＜-40°C；湿度：＜60%
	保存期限	3 个月	6 个月

拆包（回温）	保存环境	室温
	保存温湿度	温度：室温（25°C）；湿度：＜85%
	保存期限	72h

8. 修订记录

版本	发行日	内容
A/1	2022 年 8 月 22 日	新规做成